

## Produktbeschreibung

GENMA SMD Lötpaste – unsere Dispenser-Lötpaste NP303-DPS101 wurde für die hohen Anforderungen beim Laserlöten entwickelt und liefert auch beim Reflowlöten exzellente Ergebnisse. Die Lötpaste spritzt nicht beim raschen Erhitzen. Es treten keine Zinnerperlen oder Flussmittelspritzer neben der Lötstelle auf. Das Ergebnis sind optisch ansprechende Lötstellen, die von klaren Flussmittelrückständen umschlossen werden. Die Lötpaste hat eine gleichbleibende Klebekraft beim Bestücken. Durch die stabile Viskosität ist der Dispenserauftrag gleichmäßig und reproduzierbar. Nach dem Löten ist keine Reinigung notwendig. Die Lötpaste kann unter Luft oder Schutzgas gelötet werden.

## Technische Eigenschaften

	Spezifischer Wert	Testmethode
Legierung (wt %)	Sn 96,5 / Ag 3,0 / Cu 0,5 / SAC305	
Schmelzbereich (°C)	217 - 221	IEC61189-11
Pulvergröße (µm)	10 - 25, Typ 5	IPC-TM-650-2.2.14.2
Viskosität (Pas)	130	IPC-TM-650-2.4.34.3
Flussmittelgehalt (wt %)	12,3	IPC-TM-650-2.3.34.1
Flussmitteltyp	ROLO, no clean	IPC-J-STD-004B
Halogengehalt (wt %)	< 0,03	IPC-TM-650-2.3.35
Isolationswiderstand (Ω)	$\geq 5,9 \times 10^{12}$ ( 40°C 90 % r. L )	IPC-TM-650-2.6.3.3
Isolationswiderstand (Ω)	$\geq 4,3 \times 10^9$ ( 85°C 85 % r. L )	IPC-TM-650-2.6.3.3
Migrationstest	Keine Migration	IPC-TM-650-2.6.14.1
Kupferspiegeltest	Keine Korrosion	IPC-TM-650-2.3.32
Verpackungseinheit	Kartusche (80g)	
Mindesthaltbarkeit	3 Monate bei 0-10°C	
Transport	gekühlt	
Temperieren der Lötpaste	Rechtzeitig vor dem Öffnen auf Raumtemperatur bringen	
Empfohlene Temperatur beim Dispensieren ( °C )	25 ± 3	
Empfohlene relative Luftfeuchtigkeit in % beim Dispensieren	50 ± 20	

## Konformität

Konform mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Anhang 2015/863/EU

Enthält keine Stoffe über dem Grenzwert (0,1%) gemäß REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006 (SVHC-Liste - Stand 26.02.2024)